## ⑫公開特許公報 (A)

昭57—187195

Int. Cl.3 B 23 K 35/30 // C 22 C 5/08 識別記号

庁内整理番号 6919-4E 7920-4K

邳公開 昭和57年(1982)11月17日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

多銀ろう材

犯特 昭56-72005

2出 昭56(1981)5月13日

72発 明 者 奈良喬

> 東京都千代田区鍜冶町二丁目9 番12号株式会社徳力本店内

分発 明 者 醍醐裕人

東京都千代田区鍜冶町二丁目9

番12号株式会社徳力本店内

仍発 明 者 渡辺治

東京都千代田区鍜冶町二丁目9 番12号株式会社徳力本店内

⑪出 願 人 株式会社徳力本店

東京都千代田区鍜冶町二丁目9

番12号

邳代 理 人 弁理士 金倉喬二

1. 発明の名称

銀ろう材

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. Agが50~95%、Cuが5~50%からな る Ag - Cu 系に Si , Pb , Mg の一種または二 種以上を 0.0 5 ~ 0.5 多加えたことを特徴とす る銀ろう材。
  - 2. Agが50~95%、Cuが5~50%からな るAg - Cu 系にSi , Pb , Mg の一種または二 種を 0.05 ~ 0.5%、さらに Ge , Mn , Ni の 一種または二種以上を 0.0 0 5 ~ 1 % を加えた ことを特徴とする銀ろり材。
- 3. 発明の詳細な説明

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

本発明は真空中もしくは雰囲気中で使用する銀 ろう材に関する。

従来より金属のろう付には鍛ろり、金ろり、パ ラジウムろう。白金ろう等が用いられている。そ の中でも銀ろうは融点が比較的低く作業性がよい こと及び価格が比較的低廉であることから特殊な

場合を除いては広く用いられている。銀ろうの中 でも特に72 Ag - Cu 合金( BAg - 8 ) が電子管 や真空管等の電子部品などをはじめとして多用さ れてむり、また、触点あるいは価格を考慮して銀 の含有量を増減させた Ag - Cu 合金が使用されて いる。

しかしながら、特に電子工業の分野においては、 ろう付後の工程の関係からろう付後の表面の平滑 度が要求される。それは、ろう付後の表面の粗さ の度合が大きいとその後のはんだ付工程の作業性 が低下し、まためつき工程において前処理の脱脂 が充分に行なわれなかつたり、酸洗処理の酸が表 面に残留して表面が腐食されたりしてめつき不良 をきたす等の問題を起す虞れがあるからであり、 できるだけ平滑な表面に仕上がるろう材が要求さ れている。

そしてろう付表面の粗さの原因は以下の二つに よるものと考えられる。1) ろう材製周時に放出 されるガスによつて表面が相される。』)ろう材 疑固時の金属組織が微細化しないことにより組さ

従つて上記の原因を取除くことによりろう付面 の表面の平滑さは得られるととになる。

本発明は上記の要求を満すことを目的とし、Ag - Culc Si , Pb , Mg の一種または二種以上を加 えてろう材とするが、さらにこれにGe , Mn , Ni の一種または二種以上を添加してろう材とすると とにより平滑なろう付表面が得られることを特徴 とする。

以下、本発明を説明する。

Agを50~95%、Cuを5~50%含むAg-Cu 系に、1) Si, Pb, Mg の一種または二種以上 を0.05~0.5 乡加えてろり材とするか、さらに これに、i) Ge, Mn, Ni の一種または二種以 上を 0.005~1% 添加してろう材とする。

ここでSi, Pb, Mg は酸素と結びつきの強い 金属元素であつて、ろう材製造中およびろう材使 用中に脱ガス(脱酸素)効果を有するものであり、 その於加量は0.05%未満であると効果を上げる ことはできず、また 0.5 多以上になるとろう材の

- H) Ag 60% Cu 40% (60Ag Cu)
- (1) ろう付引張強度については下記のようを結果 を得た。

	第 1 表		単位 Kg/cm²		
武科	Cu	Ni	SUS 304	<b>軟鋼</b>	
	0 2 0	222	250	201	

試料。以料	Cu	Ni	SUS 304	軟鋼
A	2 3.9	3 2.3	3 5.0	3 0.1
В	2 3.8	3 2.5	3 4.9	3 0.0
С	2 4.3	3 4.8	3 6.6	3 3.3
D	2 4.0	3 2.4	3 5.0	3 0.2
E	2 4.2	3 4.5	3 6.2	3 2.5
F	2 4.1	3 2.6	3 5.3	3 0.2
G	2 4.0	3 2.5	3 5.0	3 0.0
н	2 4.0	3 2.3	3 5.4	3 0.4

但し、アムスラー材料試験機により行ない、 各試料の液相温度より40℃高い温度にて真空 中または水素雰囲気中でろう付を行なつた。断 面が4×4 ■の突合わせ継手を側定した。

(2) 拡がり面積試験については下記のような結果 を得た。

製造加工上あるいは使用性、上に問題が生じる。

また、Ge, Ma, Ni はろう材凝固時の金属組 縦を微細化する効果のある金属であつて、その旅 加量は0.005 多末満であるとその効果を上げる ことはできず、また、15以上になると、1) 融 点の上昇が大きくろう付使用に不便となる。ii) **売動性が低下する。 ii) 加工症が低下して鋳造後** の製造工程に支障をきたす。等の欠点の内すくな くとも1つの欠点が生ずる。

次に本発明の実施例について説明する。

- A) Ag 85% Cu 1485% Si 0.1% Mg 0.05%
- B) Ag 72% Cu 278% Pb 0.1% Si 0.1%
- C) Ag 72% Cu 27.6% Si 0.1% Ni 0.3%
- D) Ag 72% Cu 278% Pb 0.1% Ge 0.1%
- E) Ag 60% Cu 39.3% Mg 0.2% Mn 0.5%

以上の本発明の試料について、従来品との性能 を比較してみた。従来品の試料として以下の3種 を挙げる。

- F) Ag 85% Cu 15% (85Ag Cu)
- G) Ag 72% Cu 28% (BAg 8)

第 2 表

単位 ☎2

13.41	Cu	Ni	SUS 304	<b>快湖</b>
A	2 2.4	1 7.1	1 4.0	1 5.0
В	2 2.9	1 8.3	1 4.3	1 5.4
С	2 2.0	1 8.0	1 4.0	1 5.2
D	2 2.1	1 8.2	1 1.2	1 5.1
E	21.0	1 6.8	1 5.0	1 5.5
F	2 2.6	1 7.3	1 4.1	1 5.1
G	2 3.0	1 8.5	1 4.5	1 5.5
н	2 2.8	1 7.1	1 4.3	1 4.9

但し、拡がり試験は厚さ0.1 mm, 10 mm角の ろう材を用い、各ろう材の液相温度より40℃ 高い温度にて真空中または水素雰囲気中で行な い、2分間保持した。

(3) 表面相さの測定結果は第1四~第8回に示す 通りである。

但し、各ろう材の魔動後の表面組さば表面粗 さ劇定機により測定を行なつた。各ろう材はNi 仮でその液相温度より40℃高い温度において 真空中または水素雰囲気中で促動させた。

G.

**BEST AVAILABLE COPY** 

以上のように本発明によるろう材 従来のろう材と比較してまずその基本的性能についてみると、ろう付強度はほぼ同等で添加による実質的低 下はみられない。

──拡がり面積は添加元素の種類や添加量によりや や減少傾向にあるものが多いが実際使用上問題と なる程の減少ではない。

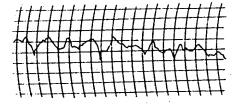
本発明の主眼であるろう付後の表面組されついては第1図~第8図から明らかな如く、添加元素の種類、添加量により若干の程度差はあるが、本発明のろう材は表面のざらつきが大きく改善され BAg-8 については特にその効果が顕著である。

以上の如く、本発明はAg-Cu系ろう材の基本 的性能を特別損りことなく、ろう付後の表面状態 を改善し、多方面に亘つて有用なろう材となる。

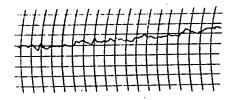
さらに本発明は、Ag - Cu 系合金の表面を脱ガス、結晶粒微細化によつて改善することにより電子工業の分野はもちろん装飾品についてもより美麗な外観を与える効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

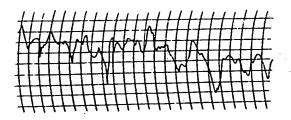
**4** 1 **3** 



**4** 2 7



44 3 国

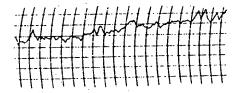


第1 図は従来品Fの表面を翻定結果を示すクラフ、第2 図は本発明Aの表面組さ測定結果を示すグラフ、第3 図は従来品Gの表面組さ測定結果を示すグラフ、第4 図は本発明Bの表面組さ測定結果を示すグラフ、第5 図は本発明Cの表面組さ測定結果を示すグラフ、第6 図は本発明Dの表面組さ測定結果を示すグラフ、第7 図は従来品Hの表面組さ測定結果を示すグラフ、第8 図は本発明Eの表面組さ測定結果を示すグラフである。

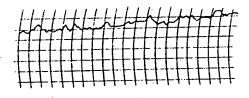
特許出願人 产式会社 德力本店

代理人 弁理士 金 倉 喬 二

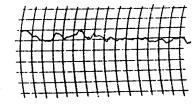
₩ 4 🗷



卷 5 🖫



**4** 6 **4** 



昭和56年6 月8 日

51, 6, 8

一特許庁長官 島田 春樹 段

1. 事件の表示

昭和56年 特許 顧 第072005 号

- 2. 発明の名称 最あり材
- 3. 補正をする者 ##tとの関係

との関係 本人

作 所 東京都千代田区銀冶町二T目9番12号

氏 名 株式会社 徳 力 本 店

(名称) 代表者 山田 晃

4. 代理 人

医 所 東京都港区新橋二丁目9番5号 中銀新橋ビル 〒105 選は (580)7743

氏 8 (6961) 弁理士 金 介 裔

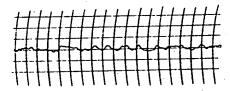
5. 補正命令の日付 (自発)

6. 補正により増加する発明の数 な し

7. 補正の対象

明細書「発明の辞細を説明の禰」 は 本上は 委任 状

€ 8 ⊡



## 8. 補正の内容

- 明細書第5頁第4行
  「kg/cal」とあるを「kg/al」と訂正する。
- 2. 委任状は別紙の通り。

BEST AVAILABLE COPY

•